

# BGA.CSP封装锡球 元素半导体

产品名称	BGA.CSP封装锡球 元素半导体
公司名称	大丰市宙心电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:元素半导体 特性:多种 用途:多种
公司地址	大丰市经济技术开发区西区
联系电话	13651581222 18761217005

## 产品详情

种类                      元素半导体                      特性                      多种  
用途                      多种

本公司为了平价国内bga/csp封装元件，因而整合了台湾、韩国、香港等地的精密技术研发人员，自主研发了国内第一家bga/csp封装用锡球生产线，在专业技术上已达到了国内外领先的技术，开发出了品质佳、封装性良好的产品，可根据客户的要求，在最短时间内供货。

我们并已取得美国爱荷华州立大学的无铅成分专利授权书，应用于未来绿色环保的无铅电子世界.....

生产的锡球品种规格主要有：有铅锡球(sn63/pb37)成分：0.1mm~1.5mm无铅锡球(sn96.5/ag3/cu0.5、sn95.5/ag4/cu0.5、sn96.5/ag3.5等)成分：0.1mm~1.5mm

特殊规格可依客户指定而生产.....

欢迎有意的朋友随时来电洽谈.....

### 公司介绍

江苏大丰宙心电子有限公司简介中国在世界半导体产业领域中，仍处于萌芽期，对于世界先进的半导体产业链的技术，可以说还处在一个探讨阶段，而世界发展的脚步如此之快，中国目前只能依靠进口元件做加工基础上的制造,从而增加了国内封装半导体成本的成本，减弱了和国外的竞争力。本公司为了平价国内bga/csp封装元件，因而整合了台湾、韩国、香港等地的精密技术研发人员，自主研发了国内第一家bga/csp封装用锡球生产线，在专业技术上已达到了国内外领先的技术，开发出了品质佳、封装性良好的产品，可根据客户的要求，在最短时间内供货。我们并已取得美国爱荷华州立大学的无铅成分专利授权书，应用于未来绿色环保的无铅电子世界.....生产的锡球品种规格主要有：有铅成

分——sn63/pb37;sn62/ag36/pb2;sn10/pb90;无铅成分——sn100;sn96.5/ag3.5;sn96.5/ag3/cu0.5;sn95.5/ag4/cu0.5  
;生产规格——0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.76/0.889/1.0/1.5(单位：mm)  
特殊规格及分成可依客户指定要求生产.....

### 详细信息

主营产品或服务：	锡线锡膏;锡球;	主营行业：	半导体材料;其他未分类
经营模式：	生产加工	企业类型：	外资企业
公司注册地：	中国 江苏 盐城	主要经营地点：	江苏省大丰市开发区西区3号路
公司成立时间：	2005	法定代表人/负责人：	谢龙翔
年营业额：		员工人数：	51 - 100 人
经营品牌：	宙心	注册资本：	美元 246万
主要客户群：	半导体封装厂	主要市场：	大陆、港澳台地区、东南亚、
年出口额：		年进口额：	
开户银行：	中国农业银行大丰市分行	帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	5 - 10 人
月产量：	30亿 粒	厂房面积：	3765 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	iso 9001; iso 14000;

### 联系方式

大丰市宙心电子有限公司邱锋 先生 (市场部副总裁)	
地址：	中国 江苏 大丰市 经济技术开发区大奇路6号
邮编：	224100
传真：	86 0515 83859000 免费试用电子传真
移动电话：	13901412688
电话：	86 0515 83263999
公司主页：	<a href="http://www.ucedfs.com">http://www.ucedfs.com</a>
	<a href="http://ucedfs.cn.alibaba.com">http://ucedfs.cn.alibaba.com</a>